

チップエミフィル 超大電流対応 部品材料表
Structure of Chip EMIFIL for very Large Current
NFM31HK type

1. 使用材料 / Material

| No. | 品名 / Item | 材料一般名 / Material |
|-----|---------------------------|--|
| ① | 誘電体 Ceramic dielectric | セラミック誘電体 Ceramic dielectric |
| ② | 外部電極 Outer electrode | 銅 + ニッケルめっき + 錫めっき Cu + Ni plating + Sn plating |
| ③ | 内部電極 Inner electrode | ニッケル Ni |

2. 内部構造 / Example of Structure

